

Fabrication of A Microcantilever Beam by Electroforming

謝庚源、王東安、李佳言

E-mail: 9510956@mail.dyu.edu.tw

ABSTRACT

This research focuses on the fabrication of a cantilever beam microstructure on a stainless steel substrate (SUS-301). Electroforming of a copper sacrificial layer and a nickel structural layer are used in the microfabrication process. A negative photoresist JSR-120N is used in the lithography process. The process parameters of soft bake, exposure and development are investigated. Pulse current is used in the electroforming process. A nickel cantilever beam is successfully fabricated by using a copper sacrificial layer and a nickel structural layer.

Keywords : electroforming, UV-LIGA, nickel structural layer, copper sacrificial layer

Table of Contents

封面內頁 簽名頁 授權書.....	iii	中文摘要.....	iv	英文摘要.....	v 誌	
謝.....	vi	目錄.....	vii	圖目錄.....	x 表目錄.....	xii 第一章
緒論 1.1 前言.....	1	1.2 研究動機與目的.....	1	1.3 本論文結構.....	3	第二章 文獻回顧 2.1
X光深刻電鑄模造技術 (LIGA)	4	2.2 微影技術原理.....	6	2.3 光阻介紹.....	9	2.4 電鑄原
理.....	11	2.5 影響電鑄品質的因素.....	17	第三章 實驗方法 3.1 製程步驟.....	21	3.2 電鑄的基本
配備.....	24	3.3 電鑄製程.....	25	3.4 去光阻實驗.....	31	3.5 溶解銅實驗.....
實驗觀察與量測.....	32	4.1 微影製程改進.....	34	4.2 電鑄製程探討.....	37	4.3
去除光阻(JSR-120N).....	38	4.4 溶解銅犧牲層之研究.....	40	第五章 結論 5.1 結論.....	41	5.2 未來
工作.....	41	參考文獻.....	69			工作

REFERENCES

- [1] W.S.N. Trimmer, 1989, Microrobots and micromechanical system, Sensors and Actuators 19(3) 267-287.
- [2] 王俊傑 , 2003 , 大伸展式微熱致動器在微定位裝置上的研究 , 國立交通大學 , 碩士論文。
- [3] S.E. Alper, T. Akin, 2004, Symmetrical and decoupled nickel microgyroscope on insulating substrate, Sensors and Actuators A 115 336-350.
- [4] http://www.itri.org.tw/chi/rnd/advanced_rnd/sustainable_dev/XF94-05.jsp [5] 楊啟榮、強玲英、黃奇聲 , 2000 , 微系統LIGA 製程之精密電鑄技術 , 科儀新知 21(6) 15-27.
- [6] 楊啟榮、強玲英、郭文凱、林郁欣、林暉雄、張哲璋、趙俊傑 , 2001 , 微系統類LIGA 製程光刻技術 , 科儀新知 22(4) 33-45.
- [7] 黃皇齊 , 2004 , 應用UV-LIGA於導光板模仁之製作研究 , 國立高雄應用科技大學 , 碩士論文。
- [8] 張振銓 , 2002 , 高深寬比微結構模仁的製作程序的研究—利用矽基加工技術 , 國立清華大學 , 碩士論文。
- [9] 魏茂國 , 1998 , 準分子雷射應用於奈米加工技術簡介 , N ewsletter of the Chinese Society of Mechanism and Machine Theory,1-6.
- [10] M.J. Madou, L. Yu, C.G. Koh, L.J. Lee, K.W. Koelling, 2002, Experimental investigation and numerical simulation of injection molding with micro-featuers, Polymer Engineering and Science 42(5) 871-888.
- [11] 莊達人 , 1994 , VLSI 製造技術 , 高立圖書。
- [12] 邱燦賓 , 1998 , 微影製程之數學模式 , 奈米通訊 , 國家奈米元件實驗室 , 第五卷第三期 , 30-37.
- [13] 李振榮 , 厚膜光阻、LIGA、微系統簡介 , 國立高雄第一科技大學 , <http://www2.nkfust.edu.tw/~jcyu/Course/MEMS%20Lab/LIGA.pdf>。
- [14] S.D. Leith, D.T. Schwartz, 1999, High-rate through-mold electrodeposition of thick (>200 μ m) NiFe MEMS components with uniform composition, Journal of Microelectromechanical Systems 8(4) 384-392.
- [15] 吳憲明 , 1997 , 精密電鑄技術市場應用 , 雷射加工暨精密電鑄技術研討會 , 台大慶齡工業 中心 , 52.
- [16] 林西音 , 1971 , 金屬電鍍學 , 初版 , 五洲出版 , 臺北市。
- [17] 侯勝發 , 2000 , Quasi-LIGA-like製程研製二維振動式微陀螺儀 , 國立成功大學 , 碩士論文。
- [18] 李鴻年、張紹恭、張炳乾、宋子玉 , 1986 , 實用電鑄工藝 , 國防工業出版社。
- [19] L. Peter, A. Cziraki, L. Pogany, 2001, Microstructure and giant magnetoresistance of electrodeposited Co-Cu/Cu multilayers, Journal of Electrochemical Society 148(3) C168-C176.

- [20] E. Toth-Kadar, T. Becsei, L. Peter, 2000, Preparation and magnetoresistance characteristics of electrodeposited Ni-Cu alloys and Ni-Cu/Cu multilayers, Journal of Electrochemical Society 147(9) 3311-3318.
- [21] 彭坤增 , 1998 , 銅模鍍鎳層組織及性質受熱潛變之研究 , 大葉大學 , 碩士論文。
- [22] J.K. Dennis, T.E. Such, 1993, Nickel and chromium plating, Woodhead Publishing Ltd, England.
- [23] 曾元宏 , 2000 , 脈衝電流應用於微電鑄最適化之研究 , 國立清華大學 , 碩士論文。
- [24] http://web547.gsfc.nasa.gov/amb/Plating/NICKEL_PLATING/nickel_plating.htm.
- [25] 簡文政 , 2004 , 脈衝電流對鎳鈷合金電鑄製程研究 , 元智大 學 , 碩士論文。